

NC277 液态助焊剂

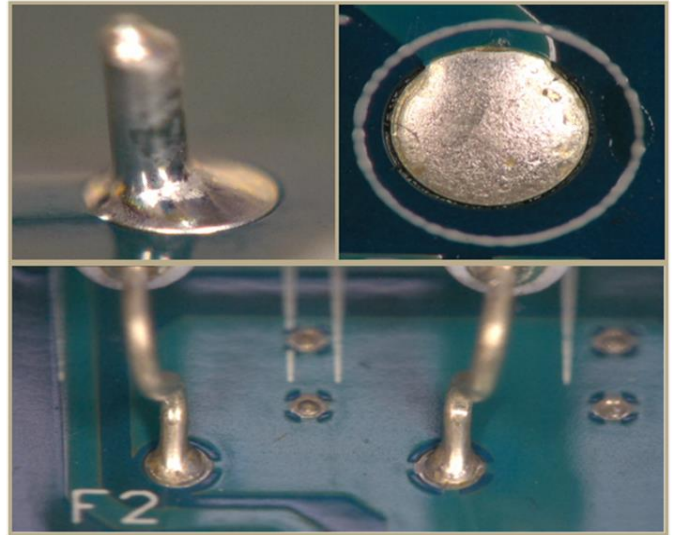
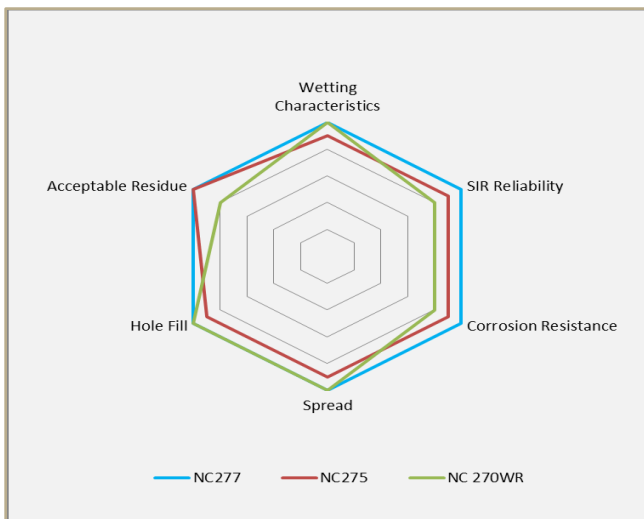
特性

- ▶ 无 VOC
- ▶ 无卤及卤素
- ▶ J-STD-004B 分类为 ORL0
- ▶ 工艺窗口广
- ▶ 符合 REACH 要求
- ▶ 中等加工后残留
- ▶ 长时间停留表现佳
- ▶ 兼容所有无铅合金

描述

NC277 是一款无 VOC 的水基液态助焊剂，其效果及可靠性可与许多醇基助焊剂媲美。NC277 是一个中等固体含量的助焊剂，其持久性及高活性可用于高温大型组装，例如电子背板、电源管理，服务器及带托盘组装。NC277 可与常用无铅波峰焊合金使用，包括锡银铜，锡银，锡铜，和其他合金。NC277 最佳应用是喷雾式，并已被证明可减少设备预防性维护要求。若产品应用需要清洗，NC277 也可清洗，尽管设计是免清洗的。

特点



处理 & 储存

参数	时间	温度
密封保质期	9 个月	4° - 40° C (40 - 100°F).

NC277 可以直接使用，无需搅拌。不要将使用过和未使用的产品混合装在同一容器内。避免光照，它可能降低产品品质。请重新密封已开容器。此产品不可冻结。

应用

NC277 可用于喷雾式、刷、雾以及浸蘸式应用，不建议泡沫式。取出后可直接使用。需将助焊剂适当覆盖，以达到并保持均匀一致。助焊剂涂层推荐初始值为 500 至 1500 微克每平方英寸。由于工艺/质量要求可能对助焊剂应用所需用量多于此指引，比如氮气波峰应用或托盘组装。

工艺指引

将热电偶贴附于PCB上表面，确保PCBA在接触波峰前的上表面温度控制在100-135C（212-275F）。对流型预热设备能提供一个更广的工艺窗口。确保助焊剂在接触波峰前完全烘干，预热未干的助焊剂会引起飞溅。少量出烟是正常现象。推荐的接触时间取决于波峰配置、炉温、合金类型和热装配。典型的推荐值为4 - 7秒。请访问 <http://www.aimsolder.com/technical-support-contacts> 联系AIM技术支持以获得工艺协助。

清洁


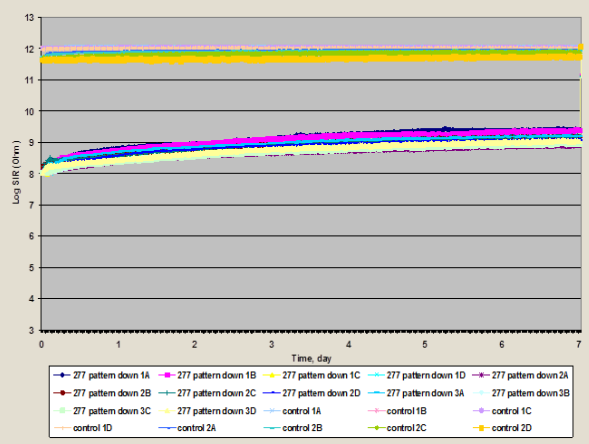
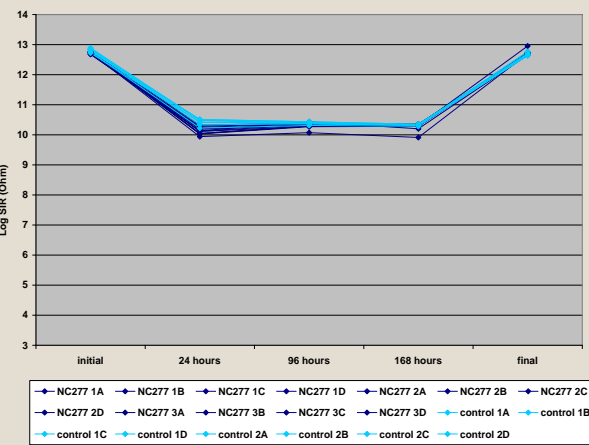
NC277 可用皂化剂或专用清洗剂清洗。建议用去离子水做最后冲洗。可联系 AIM 获得更多信息。

安全

保持通风并使用适当的个人防护设备。对任何特定的紧急情况，请参照 MSDS 信息。不要在未核准容器内处理任何有害物质。

测试数据小结

名称	测试方法	结果	图像
IPC 分类	J-STD-004	ORL0	
IPC 分类	J-STD-004B 3.3.1	ORL0	
名称	测试方法	结果	图像
铜镜	J-STD-004B 3.4.1.1 IPC-TM-650 2.3.32	低	
腐蚀性	J-STD-004B 3.4.1.2 IPC-TM-650 2.6.15	通过	
定量卤化物	J-STD-004B 3.4.1.3 IPC-TM-650 2.3.28.1	0.00%	无卤

名称	测试方法	结果	图像
定量卤化物、铬酸银测试	J-STD-004B 3.5.1.1 IPC-TM-650 2.3.33	通过	
定量卤化物、氟化点	J-STD-004B 3.5.1.2 IPC-TM-650 2.3.35.1	通过	
表面绝缘电阻	J-STD-004B 3.4.1.4 IPC-TM-650 2.6.3.7	通过	
	J-STD-004 3.4.1.4 IPC-TM-650 2.6.3.3	通过	
助焊剂固体含量、非挥发性测定	J-STD-004B 3.4.2.1 IPC-TM-650 2.3.34	5.8% 典型值	

名称	测试方法	结果	图像
酸值测定	J-STD-004B 3.4.2.2 IPC-TM-650 2.3.13	50.16mg KOH/ g flux 典型值	
助焊剂比重测定	J-STD-004B 3.4.2.3 ASTM D-1298	1.02 典型值	
PH 值 (1% solution /water)	ASTM D5464 ASTM G51	~ 2.5	
外观	J-STD-004B 3.4.2.5	无色	